

Intel Core M : Broadwell et 14 nm pour les fêtes de fin d'année ?

Intel donne aujourd'hui plus de détails sur ses futurs microprocesseurs gravés en **14 nm** avec **transistors 3D** (Tri-Gate). La firme compte sur une finesse de gravure record (la plupart des fondeurs travaillent aujourd'hui toujours en 28 nm) pour booster sa présence dans le monde de l'ultramobilité.

Les puces **Core M** seront les premières à bénéficier de la nouvelle micro-architecture processeur **Broadwell** et de la gravure en 14 nm. Avec des besoins en énergie divisés par deux par rapport à la génération précédente de processeurs mobiles Intel (Haswell), les Core M seront en mesure de fonctionner avec un refroidissement passif et offriront une meilleure autonomie sur batterie.

Ces composants sont dédiés en premier lieu **au marché des tablettes**, où ils devraient équiper des modèles d'une épaisseur inférieure au centimètre. Des processeurs bicœurs cadencés au-delà du gigahertz devraient être de la partie. Le tout avec une consommation électrique de l'ordre de **5 W**.

Disponibilité fin 2014, début 2015

Notez que le GPU intégré à ces composants a lui aussi été revu en profondeur. Ainsi, il sera capable de gérer le décodage de vidéos 4K encodées en H.265. Il se montrera également plus performant en 3D.

Les premiers produits utilisant des Core M devraient être dévoilés pour les fêtes de fin d'année, avec une plus large disponibilité prévue au cours du premier semestre 2015. La puce en 14 nm sera par la suite déclinée sur d'autres marchés : PC, serveurs et objets connectés.

Sur le même thème

[Ventes de tablettes : Estimations trop optimistes pour Samsung et Intel](#)

[Internet des objets : Intel, Dell et Samsung font bande à part](#)

[Intel injecte un FPGA dans ses puces Xeon pour datacenters](#)

Crédit photo : © Intel